



## MSL FPGA INC 晶片參數

### ■ 芯片概述

SI3453C-B02-GM是来自MSL FPGA INC美时龙的一款采用40-QFN封装的芯片，其核心参数和功能特性如下：

### ■ 核心参数

封装类型：40-QFN（四方扁平无引脚封装），具有体积小、散热性能好、电气性能优越等特点。

工作电压：典型工作电压范围为2.5V至5.5V。

输出电流：支持最高3A的输出电流。

开关频率：3MHz高频开关设计，适用于紧凑型电路布局。

### ■ 功能特性

高效率：采用峰值电流模式控制，最小导通时间仅22ns，动态响应快。

保护机制：内置过温保护、欠压降额功能，确保系统稳定运行。

可编程性：支持通过外置电阻配置输出电压和模式，灵活适应不同应用需求。

### ■ 应用场景

便携式设备：如智能手机、平板电脑等，得益于其小封装和高效率。

汽车电子：通过车规认证（如AEC-Q100），适用于车载充电器、电源管理等场景。

工业控制：宽温度范围（-40 °C至+125 °C）和抗干扰设计适合工业环境。